

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投、中信证券、远信投资、百年保险资管、东方证券、光证资管、海通资管、君和资本、旌安投资、重阳投资、太保资产、财通资管、长信基金、彤源投资、大成基金。
会议时间	2023年9月7日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	蔡国智 董事长 朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企划协理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、目前市场行情不佳，存在其他晶圆厂降价抢单的情况，公司如何应对？ 答复：产品降价只能抢占短期市场，长期来看公司会通过注重研发，改善产品性能、提高生产效率、给客户完整解决方案等方式去来赢得客户，提升市场份额。</p> <p>问题 2、请介绍一下公司主要经营模式的演变情况？ 答：自设立以来，公司始终采用晶圆代工模式，经营模式未发生变化。在晶圆代工模式下，公司主营业务不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工服务。</p> <p>问题 3、请问下半年的价格策略是什么样的？ 答复：目前的价格已经回稳，后续发展趋势不好预测，整体会随行就市。</p>

	<p>问题 4、公司的扩产节奏？</p> <p>答复：公司目前的产能为 11 万片/月，今年计划在 55 纳米制程上再扩充 1 万片/月的产能。公司计划根据市场的复苏情况弹性规划扩产计划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 11 日